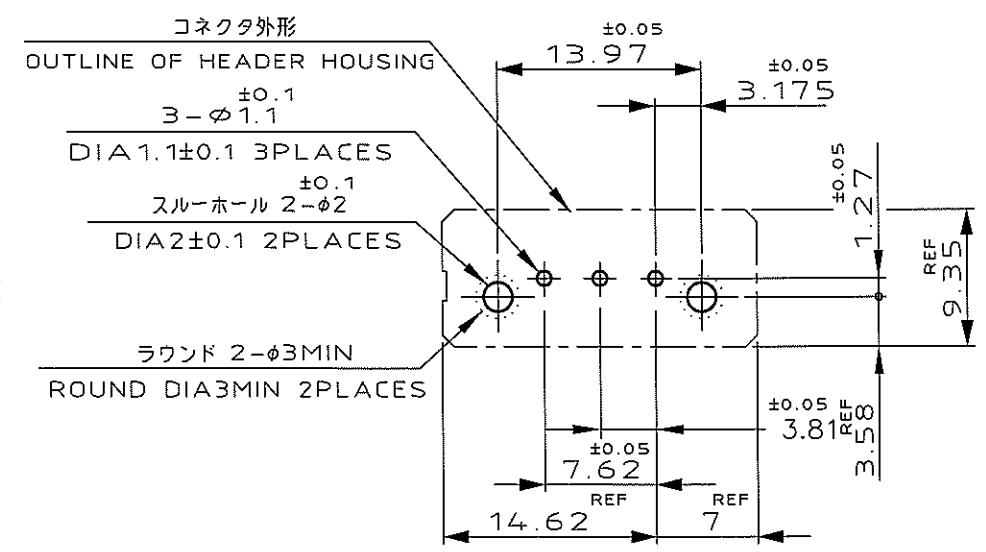
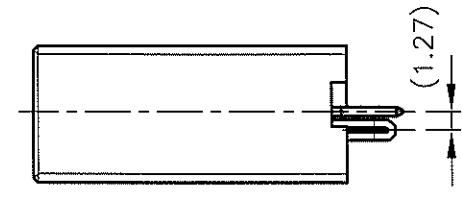
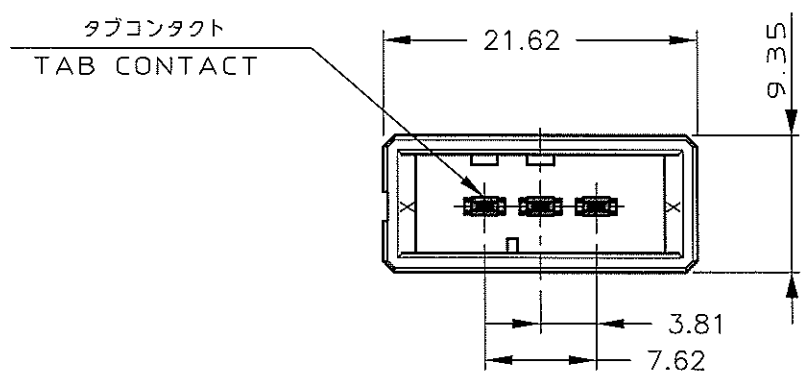
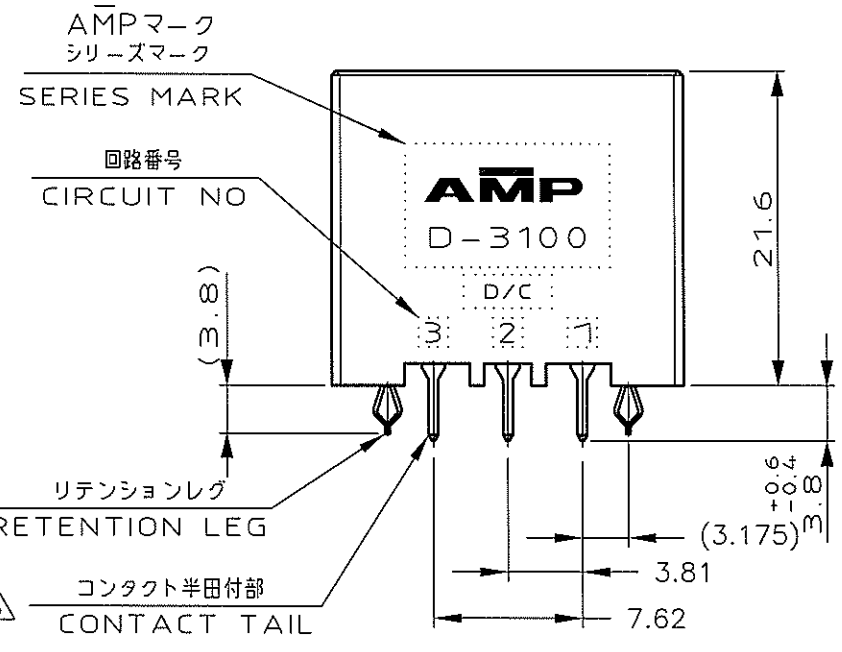


NUMBER 178313
 METRIC
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
 PRINT DIST



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)



NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

	Y	BLACK	△6 △4	2-178313-5
		BLACK	△6 △3	2-178313-3
		BLACK	△6 △2	2-178313-2
	X	NATURAL	△6 △4	6-178313-5
		BLACK	△6 △4	1-178313-5
		BLACK	△6 △3	1-178313-3
		BLACK	△6 △2	1-178313-2
キーイング KEYING LOCATION	位置 KEYING	ハウジング色 HOUSING COLOR	FINISH	製品番号 PART NO.

										TE TE Connectivity	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME							
mm(AWG -)		mm		3 POS SINGLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100							
MATERIAL		FINISH		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE	LOC	NUMBER			
SEE NOTE 注記参照		SEE NOTE 注記参照		10% : ±0.3 30% : ±0.4 100% : ±0.45 角 : ±3'		A3	J	C-178313			
E1 REVISED PER ECO-11-005030		RK	HMR	14 APR 11	DR.	18 JUN 91		DE.		18 JUN 91	
LTR REVISION RECORD		DR	CHK	DATE	CHK.	20 APR 94		APP.		20 APR 94	
					S. MANABE		S. MANABE				
						SCALE		REV.	SHEET		
						2-1		E1	1 OF 1		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-178313-5](#)